

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

741

ML6

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

02.09.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
Polyimid 50µ -18µ eins CU Kleberlos 460x305...	50201120	<div>18</div> <div>50</div>	VS	<div>1</div> <div></div>
A-RS-FR4-Prepreg-106-LowFlow-R1551LE	50200912	<div>50</div>		<div>2</div> <div>A01</div>
A-RS-FR4-ML-0.25mm-018+018-TG150-HF	50200928	<div>18</div> <div>250</div> <div>18</div>	<div>L2</div> <div>L3</div>	<div>3</div> <div>A02</div>
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	<div>110</div>		<div>4</div> <div data-kind="parent" data-rs="2">B00</div>
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	<div>0</div>		<div>5</div> <div data-kind="ghost"></div>
A-RS-FR4-ML-0.25mm-018+018-TG150-HF	50200928	<div>18</div> <div>250</div> <div>18</div>	<div>L4</div> <div>L5</div>	<div>6</div> <div>A03</div>
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	<div>57</div>		<div>7</div>
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	<div>18</div>	RS	<div>8</div>

Dicke nach Verpressen

B00:

890 µm

Tol+:

100 µm

Tol-:

100 µm

Dmax:

990 µm

Dmin:

790 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1000 µm

Tol+:

100 µm

Tol-:

100 µm

Dmax:

1100 µm

Dmin:

900 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

875 µm

Version 1.2.16.24

© Würth Elektronik